

2026 年 06 月 08 日

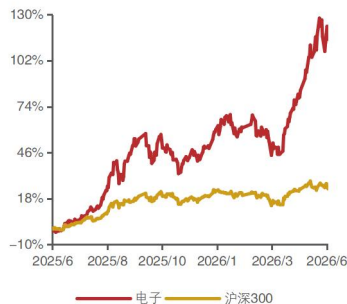
投资评级：看好（维持）

证券分析师

葛星甫
SAC: S1350524120001
gexingfu@huayuanstock.com

联系人

板块表现：



台积电股东大会要点解读，AI 拉动产业链周期向上

——电子行业周报（20260601——20260605）

投资要点：

- **周度行情复盘：**本周（2026.6.1–2026.6.5），申万电子周涨幅为-0.82%。本周电子行业细分板块中涨跌幅前三分别为：面板、被动元件、半导体材料，涨跌幅分别为15.60%、9.68%、5.53%；涨跌幅排行后三：半导体设备、集成电路封测、模拟芯片设计，涨跌幅分别为：-3.75%、-3.96%、-5.07%。本周申万电子板块个股涨跌幅前五分别为麦捷科技、美迪凯、戈碧迦、钧崴电子、华特气体，涨跌幅分别为52.71%、51.04%、43.53%、40.28%、37.46%；涨跌幅后五：利通电子、朗特智能、东田微、光智科技、强达电路，涨跌幅分别为-25.07%、-19.58%、-16.83%、-15.44%、-15.31%。
- **台积电股东大会要点解读：**AI 拉动产业链周期向上，重视 AI agent 落地带来的产业新机遇：台积电召开股东大会，作为晶圆代工环节的标杆性企业，其指引具有重要的参考意义，我们针对以下几点作出解读：
 - **1）持续看到 AI 模型在消费端、企业端及主权 AI 的应用率不断提升，Token 消耗量的激增推动算力需求，驱动先进半导体需求增长，除数据中心外，后续或将广泛落地于 PC/手机/汽车等 IoT 场景，客户持续给台积电对于 AI 产业的正面展望。**解读：半导体产业的波动体现为“周期+成长”，周期性来自于供需关系的动态平衡，成长性来自于每一轮的技术创新周期，台积电 26Q1 超 60% 的收入来自于 HPC（高性能计算），26% 来自于智能手机，这仅仅是 AI 驱动下数据中心层面的需求膨胀，随着 AI Agent 的日渐成熟，产业已经开启了端侧 AI 化的探索，或将逐渐描绘出端侧 AI 化的探索路径，有望激发 IoT 场景下的换机周期和硬件升级，或基于此原因，台积电才给出了 26 年预计 30% 以上的收入增长，以及对于未来几年的乐观展望。
 - **2）AI 正从 Chatbox 走向 Agent，先进半导体需求持续走高，近几年毛利率从 50% 左右提升至 26Q1 的 65% 以上，预计 26Q2 位于 65.5%~67.5%。**解读：这里真正需要理解的是【从台积电的定价逻辑出发，看懂毛利率背后隐含的产业趋势】，台积电作为晶圆代工环节龙头公司，“先进制程的技术领先性+成熟制程的成本及规模优势”赋予其行业定价权，台积电近几年的毛利率围绕 50% 左右波动，本质上是台积电自身的定价策略，但在这种定价策略下，公司 26Q1 的毛利率达到了 66%，本质上是因为先进制程的需求太过紧缺，导致台积电不得不通过价格策略来平衡供需关系，这一数据证明了 AI 驱动下的先进制程的战略稀缺性；同时，成熟制程也因为 AI 的外溢效应和产能挤出效应，出现了供需紧平衡的状态，当前成熟制程的供需矛盾有望逐渐体现到未来的经营趋势中。
 - **3）重申 2026 年资本开支位于 520~560 亿美金，内部倾向于接近上限，一方面持续加码先进制程、先进封装、特色工艺产能，另一方面成熟制程产能建设重心从粗放扩产转向高良率、高附加值产线搭建。**解读：回顾台积电过去十年的资本开支，16–20 年约为 100~200 亿美金（稳健扩产），21~24 年约为 300 亿美金（前期加

大了扩产力度，后来因为周期的下行，扩产节奏略有回落），25~26 年或将来到 400 亿美金和 560 亿美金，分析其资本开支，其实可以看到一个有意思的现象——【从年度数据来看，在 AI 初期的 23 年，公司的资本开支尚未出现大的跃迁，直到 24 年底开始，才在 25 和 26 年显著上修了资本开支计划】；另一方面，全行业扩产高景气的背景下，洁净室、厂房反而成了瓶颈环节，这导致台积电不得不清退部分成熟制程产能，转为更重要的先进封装（CoWoS），这些外溢性的成熟制程需求带来了“后排”参与者的订单景气度，而且过去几年成熟制程扩产相对保守，这种策略或在未来某个时间，激化成熟制程的供需矛盾。

- **重点关注：**半导体扩产链条（半导体设备、半导体材料、半导体零部件、洁净室）、芯片制造环节（芯片制造及封测环节），及 AI 端侧投资机会。
- **风险提示：**大厂资本开支不及预期，原材料价格波动，地缘政治与供应链风险。

内容目录

1. 行业数据

2. 行业动态

2.1. 公司公告

2.2. 产业资讯

3. 周度行情分析

4. 风险提示

5

6

6

7

8

10

图表目录

图表 1: 全球半导体销售额（十亿美元）	5
图表 2: 日本出口额：半导体制造设备当月值（百万日元）	5
图表 3: DDR4: 16Gb（美元/颗）	5
图表 4: DDR5:16Gb（美元/颗）	5
图表 5: Nand Flash（美元/颗）	5
图表 6: Nand Flash Wafer（美元/颗）	5
图表 7: 中国智能手机出货量（万台）	6
图表 8: 中国智能手表产量（万台）	6
图表 9: TV LCD 出货量（百万台）	6
图表 10: 台股 MLCC 公司营收（亿新台币）	6
图表 11: 6 月 1 日-6 月 5 日申万一级行业周涨跌幅比较（%）	9
图表 12: 6 月 1 日-6 月 5 日申万电子板块周涨跌幅比较（%）	9
图表 13: 不同时期各细分板块涨跌幅（数据截至 6 月 5 日）	9
图表 14: 6 月 1 日-6 月 5 日申万电子板块个股涨跌幅前十和涨跌幅后十	10

1. 行业数据

图表 1：全球半导体销售额（十亿美元）



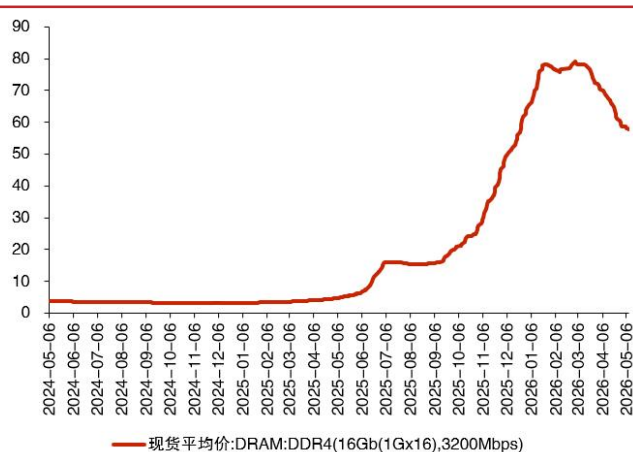
资料来源：wind，华源证券研究所

图表 2：日本出口额：半导体制造设备当月值（百万日元）



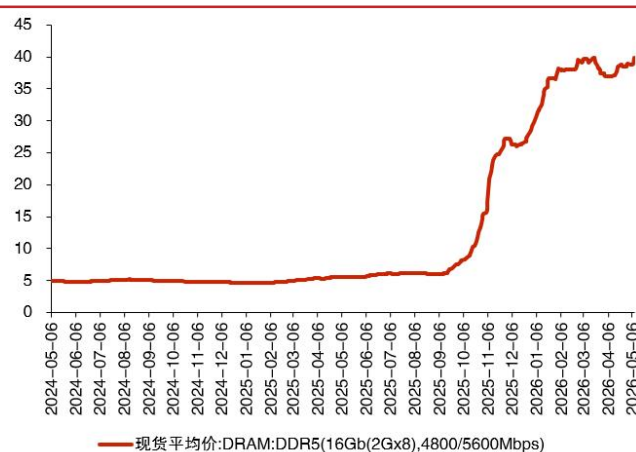
资料来源：wind，华源证券研究所

图表 3：DDR4：16Gb（美元/颗）



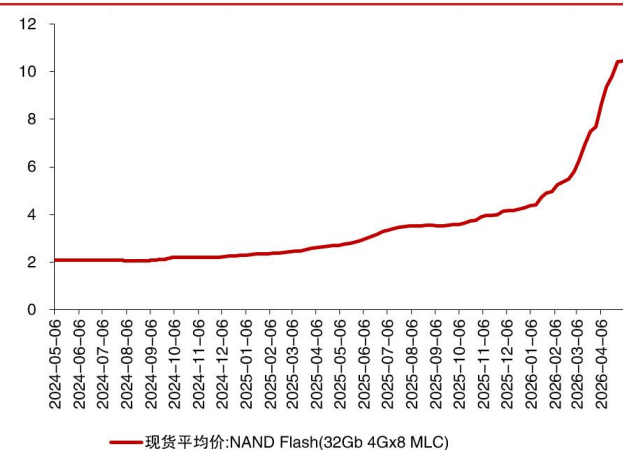
资料来源：wind，华源证券研究所

图表 4：DDR5:16Gb（美元/颗）



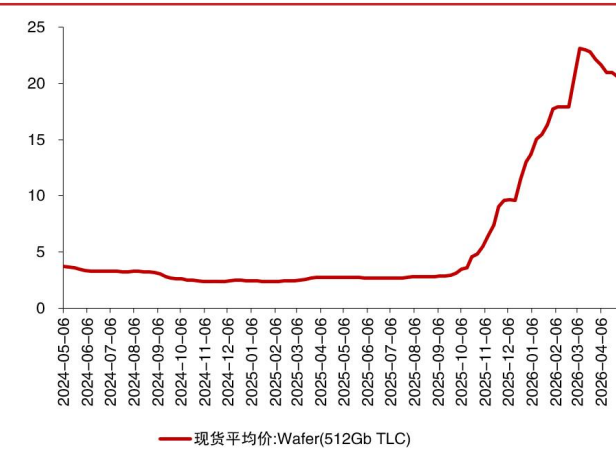
资料来源：wind，华源证券研究所

图表 5：Nand Flash（美元/颗）



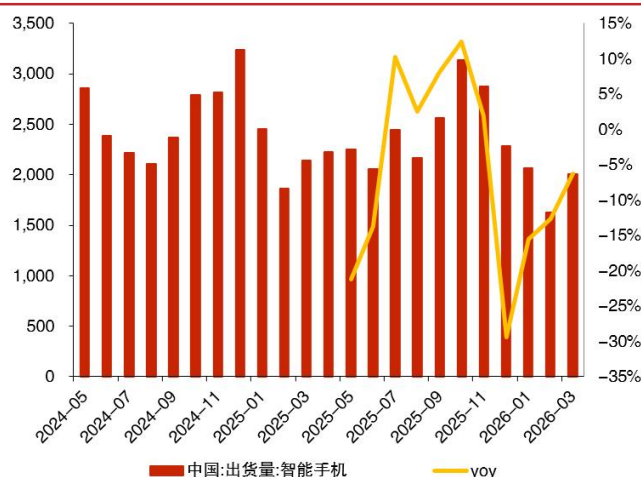
资料来源：wind，华源证券研究所

图表 6：Nand Flash Wafer（美元/颗）



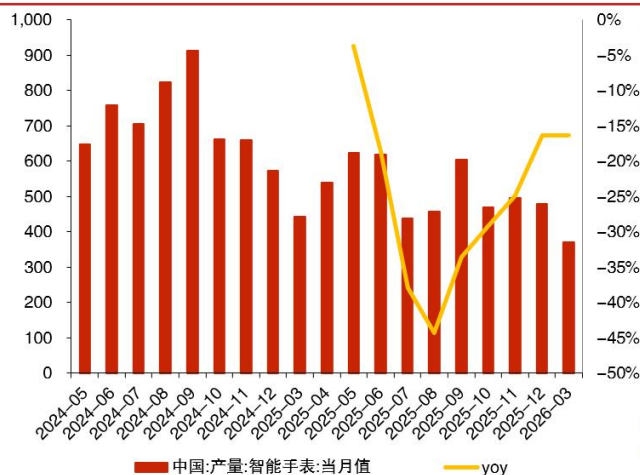
资料来源：wind，华源证券研究所

图表 7：中国智能手机出货量（万台）



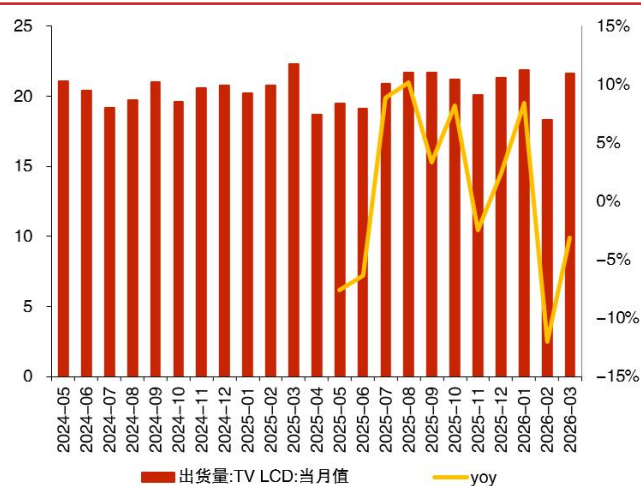
资料来源：wind，华源证券研究所

图表 8：中国智能手表产量（万台）



资料来源：wind，华源证券研究所

图表 9：TV LCD 出货量（百万台）



资料来源：wind，华源证券研究所

图表 10：台股 MLCC 公司营收（亿新台币）



资料来源：wind，华源证券研究所

2. 行业动态

2.1. 公司公告

（一）鸿富瀚发布关于调整 2026 年限制性股票激励计划激励对象名单、授予数量及授予价格的公告：

鸿富瀚于 2026 年 6 月 5 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整 2026 年限制性股票激励计划激励对象名单、授予数量及授予价格的议案》。本次调整后，公司 2026 年限制性股票激励计划激励对象人数由 68 人调整为 66 人；授予数量由 25.5000 万股调整为 34.8224 万股；授予价格由 77.69 元/股调整为 55.13 元/股。本次调整事项已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，无需提交股东会审议。鉴于公司本次激励计划的激励对象中，2 名激励对象因离职不再具备激励对象资格，公司董事会对本激励计划的激励对象名单及授予

数量进行调整；同时，鉴于公司 2025 年年度权益分派已于 2026 年 5 月 29 日完成实施，公司根据相关规定应对限制性股票授予数量及授予价格进行相应调整。

(二) 欧菲光发布关于回购注销公司 2024 年第一期限限制性股票与股票期权激励计划部分限制性股票的公告：

欧菲光于 2026 年 6 月 1 日召开第六届董事会第二十次（临时）会议，审议通过了《关于回购注销公司 2024 年第一期限限制性股票与股票期权激励计划部分限制性股票的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。鉴于 28 名限制性股票激励对象因离职而不再具备激励对象资格，公司拟对其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 334.5 万股予以回购注销；鉴于公司 2025 年业绩未达到公司层面业绩考核要求，公司拟对 171 名限制性股票激励对象第二个解除限售期已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 918.099 万股予以回购注销。本次合计回购注销 1,252.599 万股限制性股票，回购价格为 4.45 元/股，回购总金额为 55,740,655.50 元，资金来源为公司自有资金。本次回购注销完成后，公司总股本将由 3,358,271,750 股变更为 3,345,745,760 股。

(三) 德明利发布董事会薪酬与考核委员会关于回购注销 2023 年和 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票事项的核查意见：

德明利董事会薪酬与考核委员会对公司回购注销 2023 年和 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票事项相关资料进行了审核。经审核，2023 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的 1 名激励对象和 2024 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的 1 名激励对象已离职，不再具备激励对象资格，公司应按照相关规定对其已获授尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。其中，2023 年限制性股票激励计划回购数量为 1,528 股，回购价格为 12.86 元/股，回购价款约为 19,650.08 元；2024 年限制性股票激励计划回购数量为 1,260 股，回购价格为 31.55 元/股，回购价款约为 39,753.00 元。上述回购数量共计 2,788 股，回购价款共计约 59,403.08 元，回购资金来源为公司自有资金。

2.2. 产业资讯

1) 台积电表示 AI 需求推动先进半导体芯片需求增长：6 月 4 日，台积电首席执行官魏哲家在新竹举行的年度股东大会上表示，得益于人工智能带来的强劲需求，公司对未来几年的增长充满信心。魏哲家表示，AI 模型在消费者、企业和主权级应用中的采用率不断提升，推动对更强计算能力的需求，进而支撑对先进半导体芯片的需求；同时，公司目前产能有限，未来数年内全球芯片供应可能都无法完全满足 AI 带动的需求。在定价策略方面，魏哲家表示有意提高产品价格以保障盈利，但不会效仿存储芯片厂商突然大幅涨价。台积电已购入 ASML 下一代 High-NA EUV 光刻机用于研发，但由于当前成本偏高，尚未投入量产。（电子工程专辑）

2) 华虹公司更名为华虹宏力半导体，A 股及港股证券简称统一：6 月 3 日晚间，华虹宏力半导体有限公司发布公告称，自 2026 年 6 月 8 日起，公司 A 股证券简称由“华虹公司”变更为“华虹宏力”，扩位证券简称由“华虹半导体公司”变更为“华虹宏力半导体”；公司港股中文股份简称由“华虹半导体”变更为“华虹宏力”，英文股份简称由“HUA HONG

SEMI”变更为“HUA HONG GRACE”，A股及港股证券代码均保持不变。公司香港名称变更登记已完成，香港公司注册处已于2026年5月27日核发《公司更改名称证明书》。公司表示，本次变更公司名称及证券简称系为更好地反映公司的企业形象，公司主营业务、发展方向等均不发生变化，不会对公司生产经营活动产生不利影响。（电子工程专辑）

3）意法半导体推出 L9963F 车规电池管理芯片升级款：意法半导体推出 L9963F 车规电池管理芯片。L9963F 是意法半导体成熟量产款 L9963E 的增强版，L9963 系列现有用户无需改动软硬件，即可用 L9963F 直接替换 L9963E。该芯片具备混动汽车和纯电动汽车锂电池组管理系统所需功能，也适用于工业储能系统和 48 伏、96 伏电动设备。单颗芯片可监测 4 至 14 颗串联电芯，适用于最高 48V 的系统；级联多颗芯片后，最多可监测 31 个电池组、434 颗串联电芯。L9963F 符合 ISO 26262 标准，可满足 ASIL-D 等级功能安全应用要求，现已量产，采用 10mm×10mm TQFP64 封装。（电子工程专辑）

4）三星电子首次位居全球车载存储半导体市场份额第一：根据标准普尔全球汽车（S&P Global Mobility）于 5 月 31 日发布的报告，三星电子在全球车载存储半导体市场的份额已超过美光科技，首次位居全球第一。数据显示，2025 年三星电子在全球车载存储市场的份额由 2024 年的 35% 提升至 40%，同比提升 5 个百分点；美光科技市场份额则由 40% 下降至 36%。在车载 DRAM 和 NAND 闪存产品上，三星电子市占率分别达到 44% 和 33%。自 2020 年至 2025 年期间，三星电子车载存储业务年均销售额增长率超过 40%，目前已形成涵盖 LPDDR、UFS、车载 SSD 及 GDDR 的产品矩阵。（电子工程专辑）

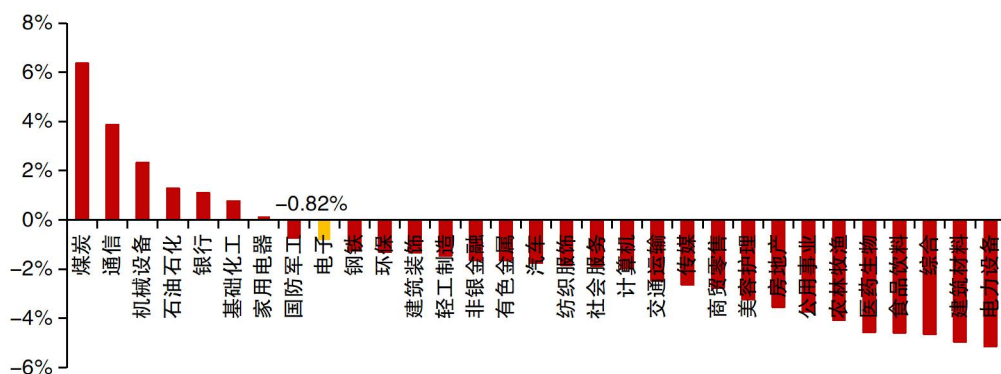
5）人形机器人主力机型近期集中降价，消费级入门款价格跌破万元：人形机器人行业近期出现集中降价，多家厂商主力机型价格下探。宇树科技 G1 售价降至 8.5 万元起，R1 起售价为 2.99 万元；加速进化 K1 系列限时促销售价为 2.99 万元；优必选价格从 12.8 万元起；松延动力 Bumi 价格降至 9,998 元。二级市场方面，2024 年和 2025 年的旧款及样机，如宇树 H1 早期科研版、傅利叶 GR-1、云深处 DR 系列，当年购入价在 30 万至 80 万元之间，目前二手行情约为 3 万至 6 万元。宇树科技招股书显示，公司人形机器人单价由 2023 年的 59.34 万元降至 2024 年的 26.07 万元，2025 年前三季度进一步降至 16.76 万元；2025 年公司实现营业收入 16.99 亿元，扣非后归母净利润 5.91 亿元，主营业务毛利率由 2023 年的 44.22% 上升至 2025 年的 60.13%。（电子工程专辑）

6）美国关注中国 PCB 供应依赖，全球 PCB 行业规模预计 2026 年达近 960 亿美元：中国制造的印刷电路板（PCB）引发美国“国家安全担忧”，据美国印刷电路板协会数据，曾经全球约 30% 的 PCB 供应来自美国，目前该比例已下降至 4%；当前 60% 的 PCB 在中国大陆制造。根据路透社援引高盛报告，3 月至 4 月间，全球 PCB 价格上涨 40%。美国 PCB 制造商迅达科技表示，公司正在将价格提高 5% 至 25%。（电子工程专辑）

3. 周度行情分析

行情跟踪：本周（2026.6.1–2026.6.5），申万电子周涨幅为-0.82%。

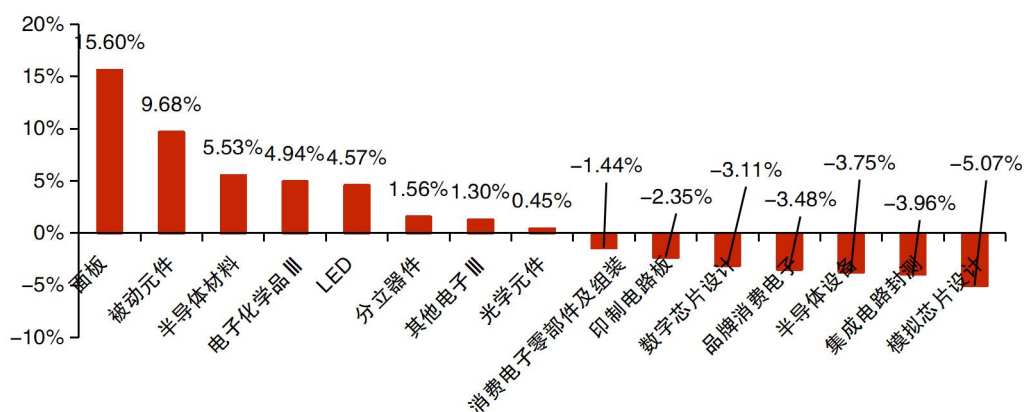
图表 11：6 月 1 日-6 月 5 日申万一级行业周涨跌幅比较 (%)



资料来源：ifind，华源证券研究所

本周电子行业细分板块中涨跌幅前三分别为：面板、被动元件、半导体材料，涨跌幅分别为 15.60%、9.68%、5.53%；涨跌幅排行后三：半导体设备、集成电路封测、模拟芯片设计，涨跌幅分别为：-3.75%、-3.96%、-5.07%。

图表 12：6 月 1 日-6 月 5 日申万电子板块周涨跌幅比较 (%)



资料来源：ifind，华源证券研究所

图表 13：不同时期各细分板块涨跌幅（数据截至 6 月 5 日）

	近一周	近一月	近一季度	近半年	近一年
面板	15.6%	26.9%	22.9%	29.0%	42.6%
被动元件	9.7%	67.7%	102.8%	154.7%	212.6%
半导体材料	5.5%	23.6%	40.9%	79.6%	123.9%
电子化学品Ⅲ	4.9%	14.6%	35.8%	75.0%	131.6%
LED	4.6%	3.6%	-5.6%	15.2%	36.6%
分立器件	1.6%	17.2%	48.6%	77.9%	154.5%
其他电子Ⅲ	1.3%	3.8%	17.1%	30.4%	88.4%
光学元件	0.4%	9.4%	30.2%	47.5%	92.9%
消费电子零部件及组装	-1.4%	7.4%	26.5%	25.5%	106.7%
印制电路板	-2.4%	20.7%	62.0%	88.2%	270.4%
数字芯片设计	-3.1%	2.9%	33.7%	49.0%	116.9%

品牌消费电子	-3.5%	-4.3%	6.5%	-8.4%	-5.0%
半导体设备	-3.7%	13.8%	32.7%	61.3%	140.4%
集成电路封测	-4.0%	32.7%	38.7%	78.9%	125.9%
模拟芯片设计	-5.1%	1.8%	19.0%	27.9%	35.0%

资料来源：ifind，华源证券研究所

图表 14：6 月 1 日-6 月 5 日申万电子板块个股涨跌幅前十和涨跌幅后十

涨跌幅前十			涨跌幅后十		
公司代码	公司名称	周涨跌幅（%）	公司代码	公司名称	周涨跌幅（%）
300319.SZ	麦捷科技	52.71%	603629.SH	利通电子	-25.07%
688079.SH	美迪凯	51.04%	300916.SZ	朗特智能	-19.58%
920438.BJ	戈碧迦	43.53%	301183.SZ	东田微	-16.83%
301458.SZ	钧崑电子	40.28%	300489.SZ	光智科技	-15.44%
688268.SH	华特气体	37.46%	301628.SZ	强达电路	-15.31%
688146.SH	中船特气	32.32%	688381.SH	帝奥微	-14.67%
300285.SZ	国瓷材料	28.61%	300739.SZ	明阳电路	-14.63%
603773.SH	沃格光电	27.21%	688508.SH	芯朋微	-14.25%
603890.SH	春秋电子	25.92%	688183.SH	生益电子	-14.24%
000725.SZ	京东方A	25.83%	300456.SZ	赛微电子	-13.95%

资料来源：ifind，华源证券研究所

4. 风险提示

- （1）大厂资本开支不及预期：全球云厂商、AI 巨头及芯片制造龙头的资本开支增速若放缓，可能导致行业内企业营收及盈利端承压。
- （2）原材料价格波动：贵金属及特种气体等上游材料的价格受地缘与供需影响，成本传导不畅将侵蚀中游制造环节利润。
- （3）地缘政治与供应链风险：国际贸易政策不确定性仍存，关税壁垒及技术出口管制升级可能导致关键设备、材料供应受限，抬升产业链成本。

证券分析师声明

本报告署名分析师在此声明，本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，本报告表述的所有观点均准确反映了本人对标的证券和发行人的个人看法。本人以勤勉的职业态度，专业审慎的研究方法，使用合法合规的信息，独立、客观的出具此报告，本人所得报酬的任何部分不曾与、不与、也不将会与本报告中的具体投资意见或观点有直接或间接联系。

一般声明

华源证券股份有限公司（以下简称“本公司”）具有中国证监会许可的证券投资咨询业务资格。

本报告是机密文件，仅供本公司的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司客户。本报告是基于本公司认为可靠的已公开信息撰写，但本公司不保证该等信息的准确性或完整性。本报告所载的资料、工具、意见及推测等只提供给客户作参考之用，并非作为或被视为出售或购买证券或其他投资标的的邀请或向人作出邀请。该等信息、意见并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。客户应对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特殊需求，必要时就法律、商业、财务、税收等方面咨询专家的意见。对依据或使用本报告所造成的一切后果，本公司及/或其关联人员均不承担任何法律责任。任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。

本报告所载的意见、评估及推测仅反映本公司于发布本报告当日的观点和判断，在不同时期，本公司可发出与本报告所载意见、评估及推测不一致的报告。本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。除非另行说明，本报告中所引用的关于业绩的数据代表过往表现，过往的业绩表现不应作为日后回报的预示。本公司不承诺也不保证任何预示的回报会得以实现，分析中所做的预测可能是基于相应的假设，任何假设的变化可能会显著影响所预测的回报。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

本报告的版权归本公司所有，属于非公开资料。本公司对本报告保留一切权利。未经本公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式修改、复制或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。如征得本公司许可进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“华源证券研究所”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。本公司保留追究相关责任的权利。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。

本公司销售人员、交易人员以及其他专业人员可能会依据不同的假设和标准，采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论或交易观点，本公司没有就此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。本公司的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。

信息披露声明

在法律许可的情况下，本公司可能会持有本报告中提及公司所发行的证券并进行交易，也可能为这些公司提供或争取提供投资银行、财务顾问和金融产品等各种金融服务。本公司将会在知晓范围内依法合规的履行信息披露义务。因此，投资者应当考虑到本公司及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突，投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一参考依据。

投资评级说明

证券的投资评级：以报告日后的 6 个月内，证券相对于同期市场基准指数的涨跌幅为标准，定义如下：

买入：相对同期市场基准指数涨跌幅在 20% 以上；

增持：相对同期市场基准指数涨跌幅在 5% ~ 20% 之间；

中性：相对同期市场基准指数涨跌幅在 -5% ~ +5% 之间；

减持：相对同期市场基准指数涨跌幅低于 -5% 及以下。

无：由于我们无法获取必要的资料，或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事件，或者其他原因，致使我们无法给出明确的投资评级。

行业的投资评级：以报告日后的 6 个月内，行业股票指数相对于同期市场基准指数的涨跌幅为标准，定义如下：

看好：行业股票指数超越同期市场基准指数；

中性：行业股票指数与同期市场基准指数基本持平；

看淡：行业股票指数弱于同期市场基准指数。

我们在此提醒您，不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准。我们采用的是相对评级体系，表示投资的相对比重建议；

投资者买入或者卖出证券的决定取决于个人的实际情况，比如当前的持仓结构以及其他需要考虑的因素。投资者应阅读整篇报告，以获取比较完整的观点与信息，不应仅仅依靠投资评级来推断结论。

本报告采用的基准指数：A 股市场基准为沪深 300 指数，香港市场基准为恒生中国企业指数（HSCEI），美国市场基准为标普 500 指数或者纳斯达克指数。